1. Přiřaďte pojmy z levého sloupce příslušným definicím vpravo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HDI |  | Je rozšíření datového formátu RS-274-D. |
|  |  |  |
| Vodivý povlak na povrchu |  | Poskytuje základnu pro vytváření obrazců obvodu. |
|  |  |  |
| Prokovy nebo VIA |  | Je elektrický spoj mezi vrstvami desky plošných spojů, který prochází rovinou jedné nebo více sousedních vrstev. |
|  |  |  |
| RS-274X |  | Zkratka používaná pro  high density interconnect - vysoká hustota propojení DPS |

1. Uveďte tři základní charakteristiky desek plošných spojů s vysokou hustotou propojení

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Upravte text tak, aby následující tvrzení byla pravdivá.

Napájecí vývody by měly být odděleny od zemnící roviny pomocí umístěných co nejblíže k napájecím vývodům integrovaného obvodu.

Obecně jsou frekvence vyšší než považovány za vysoké frekvence.

Jednovrstvé desky plošných spojů jsou vyrobeny z jediné vrstvy .

Desky plošných spojů s hliníkovým jádrem jsou složeny z b jádra, vysoce tepelně vodivé dielektrické vrstvy a standardních vrstev obvodu.

Tuhé-ohebné desky plošných spojů kombinují z obou tuhých desek a ohebných obvodů sloučených dohromady.

1. Přiřaďte pojmy z levého sloupce příslušným definicím vpravo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Floor plan |  | Týká se bíle natištěných popisků na desce plošných spojů, které identifikují součástky, testovací body, ... |
|  |  |  |
| Návrh schématu |  | Výkres, který určuje blokově umístění součástek na desce plošných spojů před nakreslením vodivých drah. |
|  |  |  |
| DRC |  | Schéma elektronického obvodu v CAD softwaru. |
|  |  |  |
| Servisní potisk |  | Je funkce CAD softwaru, která kontroluje, zda vedení drah na desce plošných spojů splňuje pravidla návrhu. |

1. Uveďte alespoň 5 základních kroků při výrobě desky plošných spojů.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Upravte text tak, aby následující tvrzení byla pravdivá.

Udržujte digitální a analogové země , protože napěťové a proudové špičky z obvodů mohou generovat rušivý šum v obvodech.

Když umisťujete součástku, délku vodivé dráhy a vyhněte se vedení dráhy pod úhlem .

Výrobci používají obrazu desky plošných spojů.

Citlivé signály by se měly od zdrojů šumu k tomu určenými rovinami a měly by být zachovány jako impedančně řízené.